

(10) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-232185

(43) 公開日 平成9年(1997)9月5日

(51) Int CL ⁶ H 01 G 4/252 4/18	識別記号 4/252	序内整理番号 4/18	F I H 01 G 1/147 4/24	技術表示箇所 C 301C
--	---------------	----------------	-----------------------------	---------------------

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全4頁)

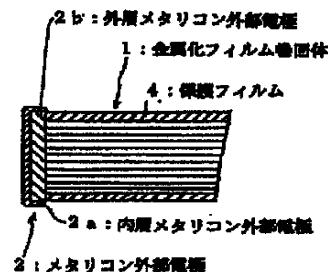
(21) 出願番号 特願平8-65433	(71) 出願人 000227205 日通工株式会社 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目6番1号
(22) 出願日 平成8年(1996)2月26日	(72) 発明者 中野 尚登 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目6番1号 日通工株式会社内

(54) 【発明の名称】 面実装型金属化フィルムコンデンサ

(57) 【要約】

【課題】 メタリコン外部電極の表面にメッキ処理を施さなくとも簡単にリフローで実装できる安価な面実装型金属化フィルムコンデンサを提供すること。

【解決手段】 プラスチックフィルムの片面に金属を蒸着してなる金属化フィルムを巻回又は積層し、該巻回体1又は積層体の端面に金属溶射によりメタリコン外部電極2を形成してなる面実装型金属化フィルムコンデンサにおいて、メタリコン外部電極2は金属溶射により形成する内層メタリコン外部電極2aと、該内層メタリコン外部電極2aの外側にホワイトメタルの溶射により形成した外層メタリコン外部電極2bとからなる。



本発明の面実装型金属化フィルムコンデンサのメタリコン外部電極部

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 プラスチックフィルムの片面に金属を蒸着してなる金属化フィルムを巻回又は横層し、該巻回体又は横層体の端面に金属溶射によりメタリコン外部電極を形成してなる面実装型金属化フィルムコンデンサにおいて、

前記メタリコン外部電極は金属溶射により形成する内層メタリコン外部電極と、該内層メタリコン外部電極の外側にホワイトメタルの溶射により形成した外層メタリコン外部電極とからなることを特徴とする面実装型金属化フィルムコンデンサ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は金属化フィルムを巻回又は横層し、該巻回体又は横層体の端面に金属溶射によりメタリコン外部電極を形成してなる面実装型金属化フィルムコンデンサに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、この種の面実装型金属化フィルムコンデンサは、プラスチックフィルムの片面に金属を蒸着してなる金属化フィルムを巻回又は横層し、該巻回体又は横層体の両端面に金属溶射、即ち溶融金属（亜鉛、半田系合金、又は銅合金等）を吹き付け、メタリコン外部電極を形成した後、エポキシ等の樹脂を含浸硬化させて構成される。しかしながら、メタリコン外部電極を構成する金属（亜鉛、半田系合金、又は銅合金）そのものはハンダ濡れ性が良好であるが、金属溶射でメタリコンとした場合ハンダ濡れ性が悪く、そのままでリフローにてプリント基板等に実装することが出来ないという問題がある。そこでメタリコン外部電極の外表面にハンダ上げ又は電気メッキ、化学メッキ等によるハンダメッキを施し、リフローで面実装できるようにしている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記従来の面実装型金属化フィルムコンデンサは、リフローにて実装を可能するために、メタリコン外部電極の表面に上記のようにハンダ上げ又は電気メッキ、化学メッキ等によるハンダメッキを施しているが、このハンダ上げや電気メッキ又は化学メッキ等のメッキ処理はその工程が複雑な為に製造コストが上昇するという問題があった。

【0004】 本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、メタリコン外部電極の表面にメッキ処理を施さなくとも簡単にリフローで実装できる安価な面実装型金属化フィルムコンデンサを提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】 上記課題を解決するため本発明は、プラスチックフィルムの片面に金属を蒸着してなる金属化フィルムを巻回又は横層し、該巻回体又は横層体の端面に金属溶射によりメタリコン外部電極を形

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

1000

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1180

1190

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1280

1290

1300

1310

1320

1330

1340

1350

1360

1370

1380

1390

1400

1410

1420

1430

1440

1450

1460

1470

1480

1490

1500

1510

1520

1530

1540

1550

1560

1570

1580

1590

1600

1610

1620

1630

1640

1650

1660

1670

1680

1690

1700

1710

1720

1730

1740

1750

1760

1770

1780

1790

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

2110

2120

2130

2140

2150

2160

2170

2180

2190

2200

2210

2220

2230

2240

2250

2260

2270

2280

2290

2300

2310

2320

2330

2340

2350

2360

2370

2380

2390

2400

2410

2420

2430

2440

2450

2460

2470

2480

2490

2500

2510

2520

2530

2540

2550

2560

2570

2580

2590

2600

2610

2620

2630

2640

2650

2660

2670

2680

2690

2700

2710

2720

2730

2740

2750

2760

2770

2780

2790

2800

2810

2820

2830

2840

2850

2860

2870

2880

2890

2900

2910

2920

2930</div

1の両端部の詳細を示す一部拡大断面図である。図示するように金属化フィルム巻回体1はプラスチックフィルム10aの片面にアルミニウム等の金属を蒸着した蒸着金属層10bを有する金属化フィルム10とプラスチックフィルム11aの片面にアルミニウム等の金属を蒸着した蒸着金属層11bを有する金属化フィルム11とを2枚重ね合わせて巻回したものである。一方の金属化フィルム10の蒸着金属層10bはメタリコン外部電極3の内層メタリコン外部電極3aに電気的に接続され、他方の金属化フィルム11の蒸着金属層11bはメタリコン外部電極2の内層メタリコン外部電極2aに電気的に接続されている。

【0012】なお、上記実施の形態では、図2に示すように、金属化フィルムを巻回し、金属化フィルムの巻回体1の両端にメタリコン外部電極2、3を設ける例を示したが、金属化フィルムの巻回体1に限定されるものではなく、金属化フィルムを積層し、その両端に内層メタリコン外部電極と外層メタリコン外部電極とからなるメタリコン外部電極を設ける構成としてもよい。なお、この場合も内層メタリコン外部電極は金属化フィルムの蒸着金属と電気的接続の良好な金属、例えば亜鉛、半田系合金、又は銅合金等の溶融金属を吹き付けて形成し、外層メタリコン外部電極はハンダの濡れ特性のよい1種又は2種(JISH5401)のホワイトメタルを吹き付けて形成する。

【0013】上記のように、本実施の形態の面実装型金属化フィルムコンデンサはその外部電極部2、3を内層と外層の2層構造とし、外層メタリコン外部電極をハンダ濡れ特性のよいホワイトメタルを用い、該ホワイトメタルを金属浴射して形成しているので、従来例のようにメタリコン外部電極の表面に工程の複雑なメッキ処理を

30 *メタリコン外部電極の表面に工程の複雑なメッキ処理を

*施すことなく、リフローにて実装できる面実装型の金属化フィルムコンデンサとなる。

【0014】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、下記のような優れた効果が期待される。面実装型金属化フィルムコンデンサの外部電極部を内層と外層の2層構造とし、外層メタリコン外部電極にハンダ濡れ特性のよいホワイトメタルを用いるので、従来例のようにメタリコン外部電極の表面に工程の複雑なハンダメッキ処理を施すことなく、リフローにて実装できる安価な面実装型金属化フィルムコンデンサを提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の面実装型金属化フィルムコンデンサのメタリコン外部電極部の構造例を示す断面図である。

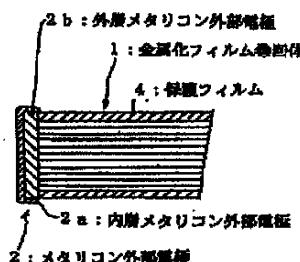
【図2】本発明の面実装型金属化フィルムコンデンサの製造工程を示す図である。

【図3】本面実装型金属化フィルムコンデンサのメタリコン外部電極と金属化フィルム巻回体の両端部の詳細を示す一部拡大断面図である。

【符号の説明】

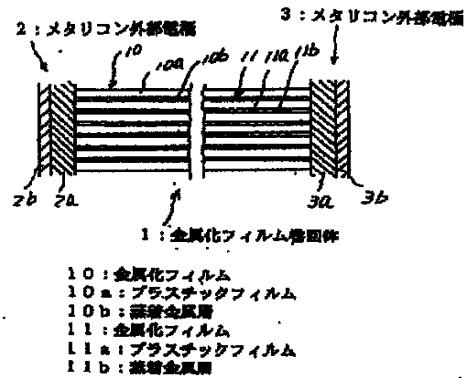
1	金属化フィルム巻回体
2	メタリコン外部電極
3	メタリコン外部電極
4	保護フィルム
10	金属化フィルム
10a	プラスチックフィルム
10b	蒸着金属層
11	金属化フィルム
11a	プラスチックフィルム
11b	蒸着金属層

【図1】



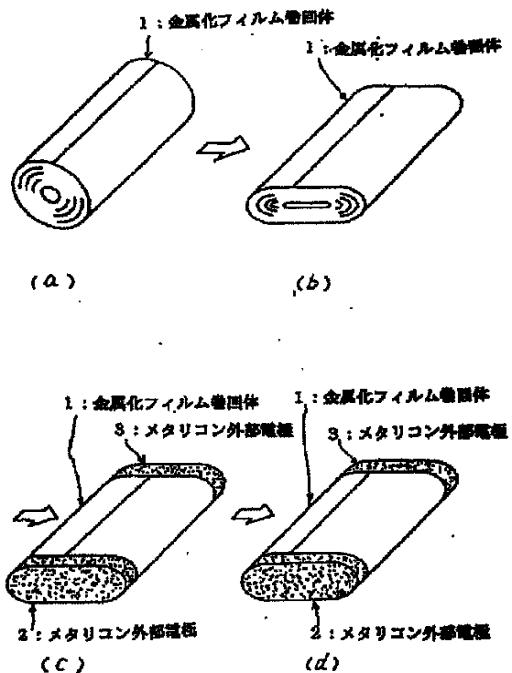
本発明の面実装型金属化フィルムコンデンサのメタリコン外部電極部

【図3】



本面実装型金属化フィルムコンデンサの一部拡大断面

【図2】



本発明の面実装型金属化フィルムコンデンサの製造工程

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-232185
 (43)Date of publication of application : 05.09.1997

(51)Int.Cl. H01G 4/252
 H01G 4/18

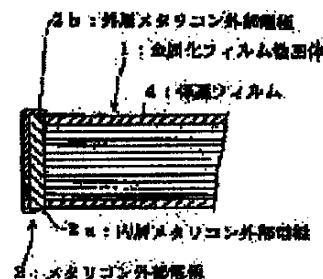
(21)Application number : 08-065433 (71)Applicant : NITSUKO CORP
 (22)Date of filing : 28.02.1996 (72)Inventor : NAKANO NAOTO

(54) SURFACE-MOUNT METALLIZED FILM CAPACITOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To mount a surface-mount metallized film capacitor by a reflow by a method wherein an external electrode part of the surface-mount metallized film capacitor is composed of a two-layer surface to an inner layer and an outer layer, and a white metal is used having excellent solder wettability for the outer layer metallicon external electrode.

SOLUTION: A metallicon external electrode 2 formed at an end part of a flattened metallized film winder body 1 comprises an inner layer metallicon external electrode 2a and an outer layer metallicon external electrode 2b formed outward of the inner layer metallicon external electrode 2a. The inner layer metallicon external electrode 2a is formed by spraying a melted metal such as zinc, solder class alloy, brass or the like excellent in electric connection with a vapor-deposited metal of a metallized film. Further, the outer layer metallicon external electrode 2b is formed by spraying a white metal melted outward of the inner layer metallicon external electrode 2a. Thereby, it is possible to obtain a low-priced face-mount metallized film capacitor capable of being simply mounted by a reflow even if plating of a face of the metallicon external electrode is not performed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]